

北京君正集成电路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号），核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司将通过发行股份及支付现金的方式向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）等 13 名交易对方购买其持有的相关资产。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 1 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》。

在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易的相关协议、方案以及股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。截至本公告披露日，本次交易已完成部分标的资产的过户手续，现将相关事宜公告如下：

一、部分标的资产过户情况

2020 年 4 月 1 日，北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）59.99% 股权过户至北京君正的工商变更登记手续办理完毕，北京矽成于 2020 年 4 月 3 日取得了换发后的《营业执照》（统一社会信用代码：91110302318129402G）。

截至目前，北京君正持有北京矽成 59.99% 股权，上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海承裕”）持有北京矽成 40.01% 股权。上海承裕的过户手续仍在办理之中，待办理完毕之后，公司将另行公告。

二、后续事项

截至本公告披露日，本次交易尚有如下后续事项待完成：

- 1、标的资产上海承裕的过户尚需完成相关工商登记变更手续；
- 2、公司尚需就本次重组向交易对方发行股份，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，同时向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续；
- 3、公司尚需根据本次交易相关协议、方案，向交易对方支付现金对价；
- 4、公司尚需在中国证监会核准批复期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜，但配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施；
- 5、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜办理工商变更登记或备案手续。

三、备查文件

- 1、北京矽成资产过户的相关证明文件

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

二〇二〇年四月七日